****

**보도자료**

**2024년 10월**

**문의:** Mediaroom@samtec.com

**삼텍, 28 Gbps NRZ 성능을 제공하는**

**초저 2mm 적층 높이의 PCB 보드 투 보드(B2B) 커넥터 출시**

**미국 인디애나주 뉴올버니:** 삼텍(Samtec)은 2mm(.078")의 초저 결합 적층 높이를 제공하고 28Gbps NRZ 성능을 지원하는 SLH/TLH 시리즈 인쇄 회로 기판(PCB)-기판(B2B) 커넥터를 출시한다고 발표했다. SLH/TLH PCB 보드-투-보드 커넥터는 삼텍의 Ultra Micro 제품군의 일부로, 전체 공간을 최대화하고 자동차, 산업용 IOT, 로봇 공학, 군사 및 항공 우주와 같은 고속 데이터 전송이 요구되는 까다로운 환경에서 안정적인 연결을 제공한다.

**공간 절약**

전체 공간 절약을 위해 2mm의 매우 낮은 적층 높이 외에도 SLH/TLH 결합 보드-투-보드 커넥터 세트는 4.70mm(.185“)의 좁은 폭과 9mm(0.356”)의 조밀한 길이, 총 20개 포지션으로 구성되어 있다. 약간 더 긴 길이의 총 40개 또는 60개 핀 커넥터를 사용하면 더 높은 밀도의 신호 라우팅이 가능하다. 이 적층 보드-투-보드 커넥터는 0.50mm(.0197") 초미세 피치에 한쪽에는 블레이드가 있고 다른 쪽에는 빔이 있는 마이크로 블레이드 및 빔 접촉 시스템을 사용하여 높은 핀 밀도를 달성한다.

**용이한 공정**
정밀한 PCB 배치는 표면 실장 기술(SMT) 보드-투-보드 커넥터를 인쇄 회로 기판에 배치할 수 있도록 해주는 폴리이미드 필름 패드를 사용한 픽 앤 플레이스 방식을 통해 이루어진다. 삼텍은 Samtec.com에서 지원 문서를 제공하여 초미세 인터커넥트의 엄격한 공정 공차를 쉽게 준수할 수 있도록 한다. 애플리케이션 관련 질문은 삼텍의 인터커넥트 프로세싱 그룹(IPG@samtec.com)으로 문의.

SLH/TLH 울트라 마이크로, 2mm의 적층 높이 보드-투-보드 PCB 커넥터는 현재 재고가 있으며, 삼텍에서 직접 또는 공인 대리점을 통해 구입할 수 있다. 샘텍의 울트라 마이크로 제품 라인에 대한 개요는 [Ultra Micro 인터커넥트 브로셔](https://suddendocs.samtec.com/literature/samtec-l18-ultra-micro-brochure.pdf?_gl=1*1o3iztk*_gcl_au*MTkwNjE1ODg0OC4xNzIyNDUwNDQx*_ga*Njk1NTIxNjEzLjE3MjI0NTA0NDE.*_ga_3KFNZC07WW*MTcyMjk1MjQzNi4yMi4xLjE3MjI5NTI0MzcuNTkuMC4w) 를 다운로드하거나 samtec.com/ultra-micro를 방문하세요.

-----------------------------

**삼텍(Samtec, Inc.) 회사 소개**

1976년에 설립된 삼텍은 고속 보드간(board-to-board), 고속 케이블, 미드 보드 및 패널 광학, 정밀 RF, 유연한 스태킹 및 마이크로/러기드 부품 및 케이블을 포함한 다양한 전자 인터커넥트 솔루션 라인을 제공하는 10억달러 규모의 비상장 제조기업이다. 삼텍 테크놀로지 센터는 베어 다이에서 100미터 떨어진 인터페이스까지, 그리고 그 사이의 모든 인터커넥트 지점에 이르는 시스템의 성능과 비용 두 가지를 모두를 최적화시키는 기술, 전략, 제품을 개발 및 최첨단화 하는데 전념하고 있다. 삼텍은 전세계 40여곳의 지사 운영과 125개국에서의 제품 판매를 통해 뛰어난 고객 서비스를 실천하며 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있다.

상세 정보는 <http://www.samtec.com>참조.

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**Phone: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**